



2007年12月3日
芝浦メカトロニクス株式会社

豊富な実績を誇るLCDドライバ用フリップチップボンダの新機種「TFC-3200」を発表

芝浦メカトロニクス株式会社（社長：森田 茂樹、横浜市栄区笠間2-5-1）は、LCDドライバパッケージに最適なCOF（Chip on Film）用高精度フリップチップボンダ「TFC-3200」を開発し、2007年9月より受注を開始いたしました。

本装置は、12月5日から開催されるSEMICON Japan 2007に出展します。

1. 開発の背景

液晶ディスプレイは高精細化・高機能化が進み、LCDドライバのファインピッチ化が進んでおり、ファインピッチ化に有利なCOFタイプの製品が拡大しています。

当社では、既にCOFに対応したフリップチップボンダを商品化し好評を得てきましたが、さらなる高速実装・高生産性を実現した新機種「TFC-3200」を開発しました。

2. 装置の特長

1) 高生産性

サイクルタイム1.4秒／ICを実現(プロセス時間含まず)し、クラストップレベルの高生産性を実現。当社従来機比約20%の生産性向上。

2) 高精度

アライメント精度2.0μm（3σ）の高精度を実現。

3) クリーン対応

ヘパフィルタを標準装備し、パーティクルを低減したクリーン仕様。

3. 今後の展開

今後も高精細化・高機能化に対応して、ボンディング精度の向上、高タクト化、クリーン化のニーズにお応えしていきます。

芝浦メカトロニクス株式会社



4. 装置外観写真



以上

本件お問い合わせ先 : 芝浦メカトロニクス(株) 広報室 葛城 誠一

TEL 045-897-2425
FAX 045-897-2470